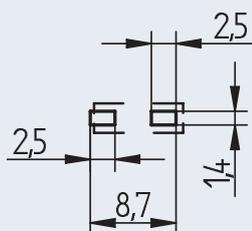


Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

Empfohlene Maße für die Lötflächen



SMD-Leiterplattenklemme Nano mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

1-polig - 46.141.1001.50

Direktes Stecken von eindrätigen Leitern

Kontaktöffnungsfunktion - zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 61076-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß
Kontaktwerkstoff: CuNi
Kontaktfläche: feuerverzinkt

Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unseres Werkzeugs 46.141.U801.89.

| Daten zur Verpackung 46.141.1001.50 | |
|---|--------------------|
| Gewicht SMD-Klemme | 0.095 g |
| Anzahl pro Spule | 4.050 |
| Durchmesser der Spule | 15" |
| Gewicht pro Spule | 0.853 kg |
| Anzahl an Spulen pro Karton | 18 |
| Anzahl an SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton | 72.900 |
| Gewicht pro Karton | 15.35 kg |
| Gewicht Karton | 1.26 kg |
| Abmessungen Karton (LxBxH) | 400 x 355 x 365 mm |
| Gesamtgewicht | 16.61 kg |



Zubehör:

SMD Nano-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in 21 mm Länge erhältlich.



46.141.U701.50



46.142.U701.50



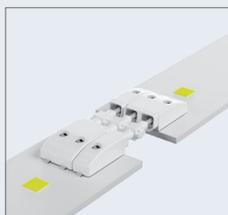
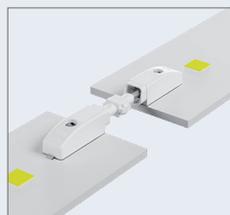
46.143.U701.50

Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter



46.141.U801.89



| Anschlussdaten | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Anschlusstechnik | Steckkontakt |
| Eindrätige Leiter | 0.2 - 0.5 mm ² , AWG 24-20 |
| Abisolierlänge | 7 ±0.5 mm |
| Leitereinführung | 0 |
| Leiterlösefunktion mittels | Werkzeug zur Kontaktöffnung |

| Auszugskraft nach DN 60999-1 | |
|------------------------------|-----------|
| 0.2 mm ² | min. 10 N |
| 0.34 mm ² | min. 15 N |
| 0.5 mm ² | min. 20 N |
| 0.75 mm ² | min. 30 N |
| Einsteckkraft | max. 10 N |

| Geometrische Daten | |
|----------------------------------|--------------------|
| Rastermaß | 3 mm / 0.12 inch |
| Breite | 3 mm / 0.12 inch |
| Höhe | 2.7 mm / 0.11 inch |
| Tiefe | 9.3 mm / 0.37 inch |
| Spulendurchmesser Gurtverpackung | 330 mm (13") |
| Gurtbreite | 16 mm |
| Pitchabstand | 8 mm |
| Verpackungseinheit Tape-and-Reel | 2.800 |
| Verpackungseinheit Karton | 50.400 (18 Spulen) |

| Werkstoffdaten | |
|-----------------------------------|---------------|
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff | PPA, weiß |
| PTI | 600 |
| Entflammbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Kontaktwerkstoff | CuNi |
| Kontaktoberfläche | feuerverzinkt |

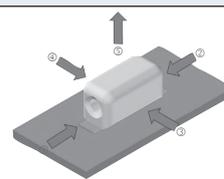
| Mechanische Daten | |
|-------------------|-------------------------|
| Montageposition | Leiterplatte oberseitig |
| Befestigungsart | Bleifreies Reflow-Löten |

| Temperaturbedingungen | |
|--|---------------------|
| Grenztemperaturbereich | -40 °C bis + 150 °C |
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis + 125 °C |
| T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12 | 120° |

| Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) | |
|---|--------|
| Bemessungsspannung (III / 3) | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 2.5 kV |
| Bemessungsspannung (III / 2) | 160 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 2) | 2.5 kV |
| Bemessungsspannung (II / 2) | 320 V |
| Bemessungsstoßspannung (II / 2) | 2.5 kV |
| Bemessungsstrom | 3 A |

| Bemessungsdaten gemäß UL 1977 | |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung UL 1977 | 320 VAC /DC |
| Bemessungsstrom UL 1977 | 3A |

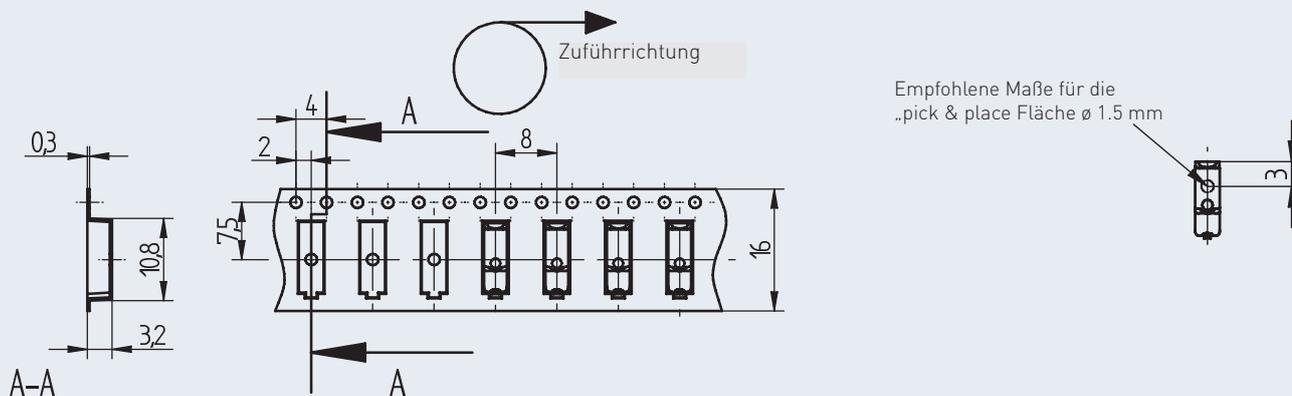
| Länderspezifische Zulassungen Zertifikate | |
|---|--------------------------|
| VDE ENEC | EN 60947 |
| UL | cURus, File No. E-365006 |

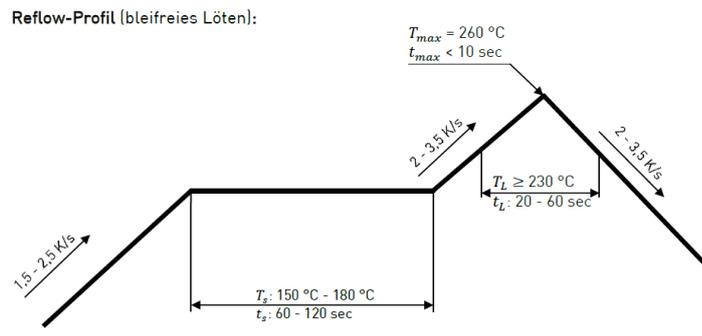
| Scherkräfte nach IEC 62137-1-2: 2007. | |
|---|--|
| Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung. |  |
| Richtung 1 + 2 Scherkraft längs | 40 |
| Richtung 3 + 4 Scherkraft quer | 15 |
| Richtung 5 Abzugskraft | 15 |

Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



| | |
|-------------------------------|---|
| Lagerdauer | Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden. |
| max. zulässige Reflowvorgänge | 3 |
| Lötprofil | <p>Reflow-Profil (bleifreies Löten):</p>  |
| Lötbarkeit | Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft |
| Montageverfahren | SMD, nach Zeichnung |
| Materialstärke SMD-Schablone | 100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150) |